

висимости $f(T_0)$ для Nb, Mo, W и иттрий-бариевых ВТС! приведены на рис. 2. При расчете этих функций использовались зависимости теплоемкости и удельного сопротивления металлов от температуры, взятые из работ [5-8].

Итак, нами показано, что расход массы конического эмиттера при прочих равных условиях однозначно определяется величиной удельного интеграла действия металла.

Список литературы

- [1] Литвинов Е.А. Автореф. докт. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1981.
- [2] Котов Ю.А. Автореф. докт. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1986.
- [3] Месяц В.Г. Автореф. канд. дис. Томск, ИСЭ СО АН СССР. 1989.
- [4] Месяц В.Г., Шкуратов С.И. Эмиссия электронов из ВТСП в условиях высоких электрических полей. Препринт УрО АН СССР. 1988. № 6.
- [5] Новицкий Л.А., Кожевников И.Г. Теплофизические свойства материалов при низких температурах. М.: Машиностроение, 1975.
- [6] Пелецкий В.Э., Бельская Э.А. Электрическое сопротивление тугоплавких материалов. Энергоиздат, 1981.
- [7] Таблицы физических величин /Под ред. Кикоина И.К. М.: Атомиздат, 1976.
- [8] Старцев В.Е. Автореф. канд. дис. Свердловск, ИФМ. 1968.

Поступило в Редакцию
6 апреля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 14

26 июля 1990 г.

06.2

© 1990

ЛЕГИРОВАНИЕ АЗОТОМ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ SiC
ПРИ РОСТЕ СУБЛИМАЦИОННЫМ „СЭНДВИЧ-МЕТОДОМ
В ВАКУУМЕ

Е.Н. Мухов, М.Г. Рамм, А.Д. Розенков,
М.И. Федоров, Р.Г. Веренчикова

Формирование приборных структур на базе SiC с требуемым распределением примеси встречает серьезные трудности, которые обычно связываются с недостаточным контролем паровой фазы в

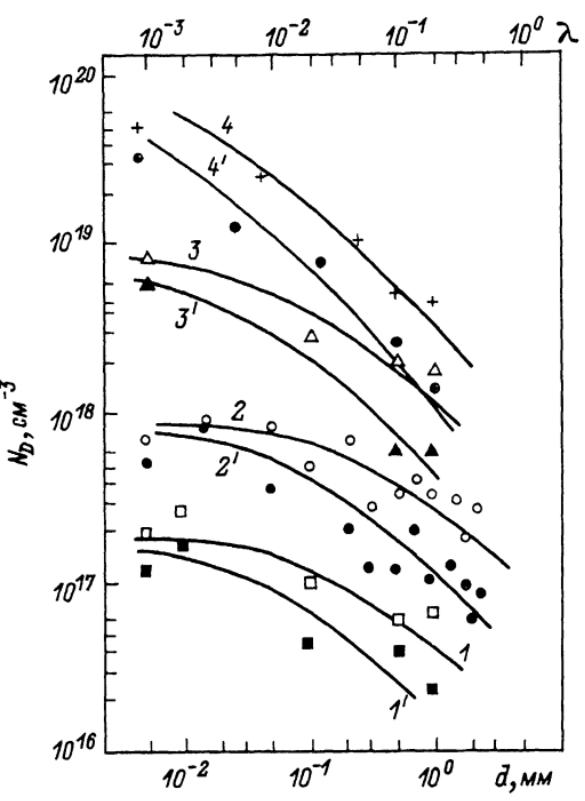


Рис. 1. Зависимость концентрации азота в ЭС $SiC(N_D EC)$, выращенных на грани $(0001)Si$ - (1-4) и грани $(0001)SiC$ - (1'-4'), от расстояния между источником и подложкой (d) и концентрации азота в источнике (N_D) $\approx 1,1' \approx 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$; $2,2' \approx 1.5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$; $3,3' \approx 10^{19} \text{ см}^{-3}$; $4,4' \approx 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Сплошные линии - теоретические кривые, полученные при следующих значениях элементарного коэффициента захвата α : 1 - 10^{-1} ; $1' - 3 \cdot 10^{-2}$; 2 - 10^{-1} ; $2' - 3 \cdot 10^{-2}$; 3 - $6 \cdot 10^{-2}$; $3' - 2 \cdot 10^{-2}$; 4 - 10^{-2} ; $4' - 3 \cdot 10^{-3}$. Параметр $\lambda = d/\alpha$, где $\alpha = 5 \text{ мм}$ - радиус источника и подложки. Температура роста ЭС $SiC \approx 1850^\circ\text{C}$; давление $P \approx 10^{-3} \text{ Па}$.

зоне роста [1]. Управление примесным составом слоев SiC усложняется также тем, что низкая скорость релаксационных процессов, происходящих в приповерхностном слое растущего кристалла, обуславливает неравновесный захват примесных атомов и тем самым является причиной сильной зависимости уровня легирования от различных кинетических факторов и ориентации поверхности подложки [2].

В настоящей работе исследуются особенности вхождения азота в SiC при сублимационном росте в связи с контролируемым легированием эпитаксиальных слоев (ЭС) SiC политипа 6Н азотом - важнейшей донорной примесью.

ЭС SiC выращивались сублимационным "сэндвич-методом" [3] в вакууме $\sim 10^{-3}$ Па при температуре $1700\text{-}2100^\circ\text{C}$. Подложками и источниками паров SiC служили монокристаллические пластины 6Н- SiC с базисными гранями $\{0001\}$ и линейными размерами 0.8 см. Расстояние между ними изменялось от 3 мкм до 2 мм. Источники были предварительно легированы азотом на уровне $10^{17}\text{-}10^{20} \text{ см}^{-3}$. Скорость роста составляла $10^1\text{-}10^3 \text{ мкм/час}$, а толщина нарошенного слоя $\sim 10\text{-}200 \text{ мкм}$.

Выращенные ЭС SiC имели плотность дислокаций $10^3\text{-}10^4 \text{ см}^{-2}$ и не содержали включений других политипов, помимо 6Н- SiC .

Определение концентрации донорной примеси (азота) - N_D в ЭС и источниках SiC проводилось путем измерения эффекта Холла и электропроводности, а также вольт-емкостным методом.

Зависимость концентрации доноров в ЭС SiC (N_D^e) от величины вакуумного зазора (d) при различном содержании азота в источнике представлена на рис. 1. Видно, что только путем вариации d можно изменять уровень легирования азота в ЭС SiC более, чем на порядок.

Количественное описание массопереноса примеси в вакуумной сэндвич-ячейке от источника к подложке, проводилось в соответствии с методикой, развитой в работе [4]. В случае достаточно высокого вакуума, для которого длина свободного пробега $\lambda_0 \gg d$ перенос примеси может быть описан уравнением (1)

$$N_D^e = N_D^{in} \alpha_i \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (1-\alpha_i)^n B^{2n} \right], \quad (1)$$

где N_D^{in} - концентрация примеси в источнике,

α_i - элементарный коэффициент захвата азота при однократном столкновении с подложкой,

B - константа, учитывающая вероятность попадания испарившегося атома на подложку, зависящая только от геометрических размеров ячейки.

Из уравнения (1), пользуясь известными значениями N_D^e , N_D^{in} , d легко рассчитать α_i . С другой стороны, исходя из известного α_i , и предполагая, что α_i остается постоянной при вариации d , можно рассчитать зависимость $N_D^e(d)$, которая для разных N_D^{in} представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, экспериментальные значения неплохо описываются расчетными кривыми. При этом значения α_i при росте ЭС SiC в направлении $[0001]C$ оказываются выше, чем в направлении $[0001]Si$. Близкие значения α_i могут быть получены также с помощью методики расчета массопереноса, развитой в работе [6].

Дальнейшее решение задачи по контролируемому легированию ЭС SiC сводится к определению величины α_i в зависимости от условий роста концентрации примеси в источнике и ориентации подложки. Анализ данных, полученных при использовании источников с различной N_D^{in} показал, что α_i можно считать постоянным лишь при низкой концентрации азота в источнике ($N_D^{in} < 1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$). При более высокой величине N_D^{in} наблюдается существенное уменьшение α_i , причем $\alpha_i \sim (N_D^{in})^{-1/2}$.

Вероятность захвата азота при росте ЭС SiC убывает с повышением температуры роста. Для низких пересыщений в зоне роста (перепад температур $\Delta T \lesssim 1^\circ$) зависимость $\alpha_i(T)$ описывается выражением (2)

$$\alpha_i = A \exp(E/RT), \quad (2)$$

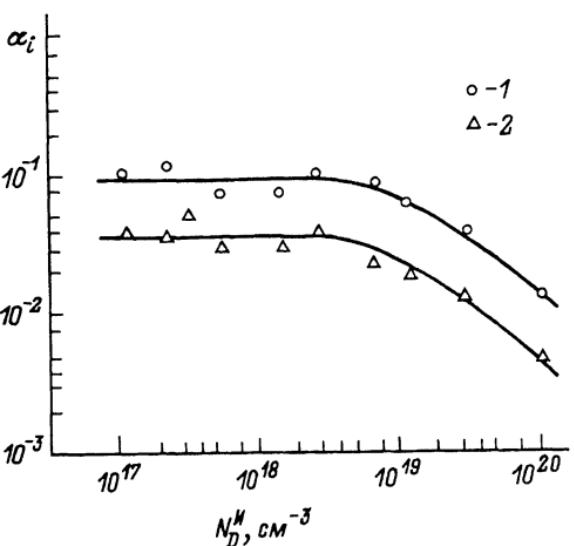


Рис. 2. Зависимость элементарного коэффициента захвата азота α_i от концентрации азота в источнике (N_D^H) при росте на гранях $(000\bar{1})C$ (1) и $(0001)Si$ (2). Температура роста $T \approx 1850$ °С. Давление $p \approx 10^{-3}$ Па.

где $E = 60$ кДж/моль; $A = 3 \cdot 10^{-2}$ и 10^{-1} (рост в направлении $[0001]Si$ и $[000\bar{1}]C$ соответственно).

Отметим, что полученные значения энергии активации

Е ниже, чем в [8]. Мы связываем это различие с тем, что в [8] при анализе влияния температуры на захват примеси не учитывалась установленная ранее [7] сильная зависимость уровня легирования от скорости роста (V_g); так, согласно приведенным в [7] данным, при высоких $V_g > 1$ мм/час α_i снижается на порядок.

Эти особенности легирования в соответствии с более ранними представлениями [5, 8] обусловлены тем, что захват примеси азота при росте ЭС SiC лимитируется стадией хемосорбции азотосодержащих молекул. Отсюда уменьшение α_i , наблюдаемое при высоком содержании примеси (рис. 2), легко объяснить за счет увеличения доли десорбирующих молекул N_2 .

На основании приведенных исследований можно сделать вывод о том, что варьируя геометрическими параметрами сэндвич-ячейки и набором источников с различным содержанием азота, представляется возможным управляя получать ЭС SiC с концентрацией примеси азота в диапазоне $10^{16} - 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Более подробный анализ показывает, что полученные значения α_i пригодны не только для описания захвата примеси при пересублимации SiC , но и могут быть использованы при изучении процесса легирования ЭС SiC из атмосферы, содержащей N_2 с учетом захвата лишь активных углеродо- и кремнийсодержащих соединений азота.

Авторы выражают благодарность Ю.А. Водакову, Г.А. Ломакиной и В.Г. Оинг за обсуждение результатов и проведение измерений.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Смит Р.А. // Полупроводники /Пер. с англ. под ред. Н.А. Пепина. М.: Мир, 1982. 558 с.
- [2] Чернов А.А. Современная кристаллография. Т. 3. М.: Наука, 1980. 231 с.
- [3] Vodakov Yu.A., Mokhov E.N., Ramm M.G., Roenkov A.D. // Krist. und Techn. 1979. V. 14. N 6. P. 729-741.

- [4] Д о р ф м а н В.Ф. // Кристаллогр. 1968. Т. 13. В. 1. С. 140-147.
- [5] В е р е н ч и к о в а Р.Г., В о д а к о в Ю.А., Г о н - ч а р о в Е.Е., Л о м а к и н а Г.А., М о х о в Е.Н., О д и н г В.Г., Р а м м М.Г., Р о е н к о в А.Д., Р я б о в а Г.Г. В кн.: «Легирование полупроводниковых материалов» М.: Наука, 1985. С. 45-52.
- [6] А л е к с а н д р о в Л.Н., Л о з о в с к и й С.В., К н я з е в С.Ю. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. В. 17. С. 1080-1084.
- [7] Р а м м М.Г., М о х о в Е.Н., В е р е н ч и к о - в а Р.Г. // Неорг. мат. 1979. Т. 15. № 12. С. 2233-2234.
- [8] Л е в и н В.И., М а д и с о н А.Е. // Известия ЛЭТИ. 1988. В. 395. С. 26-30.
- [9] В о л ь к е н ш т е й н Ф.Ф. // Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции. М.: Наука, 1987. 432 с.
- [10] L i l o v S.K., T a i r o v Yu.M., T s v e t - k o v V.F. // J. Cryst. Growth. 1977. V. 40. N 1. P. 59-68.
- [11] K i m H.J., D a v i s R.F. // J. Electrochem. Soc. 1986. V. 133. N 11. P. 2350-2357.

Поступило в Редакцию
12 марта 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 14

26 июля 1990 г.

05.2

© 1990

**ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ, ВОЗБУЖДЕННЫЙ
РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ
БРЭГГОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ И ПОЛНОГО ВНЕШНЕГО
ОТРАЖЕНИЯ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ СЛОЯХ
ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ**

С.И. Ж е л у д е в а, М.В. К о в а л ь ч у к,
Н.Н. Н о в и к о в а, И.Ю. Х а р и т о н о в

Соли Лэнгмюра-Блоджетт (Л-Б) привлекают пристальное внимание специалистов самых разных направлений. Это связано прежде всего с перспективами развития так называемой молекулярной архитектуры, позволяющей проводить контролируемое нанесение на твердую подложку органических молекул с различными физическими